

Web3.0 身分和憑證科技

- # 芯片層區塊鏈
- # 智能合約芯片
- # 實體資產代幣化
- # 第三代網絡加密資產

智能合約演示



## Web3.0身分和憑證是實體資產代幣化的重要組成部分

Real Matter Technology 仲原宇科技

是一家金融科技公司，位於香港科學園區，研究開發芯片層區塊鏈身分技術和智慧合約芯片憑證，以促進現實世界的資產代幣化，並為Web3.0 加密資產 SAAS 平台提供可驗證的解決方案：

\* 芯片層區塊鏈身分平台 \*

為身分芯片卡用戶開啟加密資產市場。

\* 智慧合約芯片上憑證平台 \*

為加密資產服務用戶開啟Web3.0資產流動性市場。

\* 實體資產代幣化平台 \*

用加密資產將整個資產管理市場開展虛擬世界市場。

產品演示

REAL MATTER

## # 虛擬代幣化 #

### 藝術作品代幣化

實體藝術創作者作為資產投資者，可以透過代幣化在藝術品銷售前提前套現；代幣持有者作為藝術品投資者，可以透過代幣化的方式分享贖回增值帶來的未來收益



### 房地產代幣化

房地產所有者作為資產投資者，可以透過代幣化將房產作為抵押品進行抵押；代幣持有者作為價值投資者，可以透過代幣化的方式贖回，分享定期抵押支付的未來利潤



### 版權標記化

版權持有者作為資產投資者，可以透過代幣化的方式提前獲得投資回報；代幣持有者作為版權所有權投資者，可以透過代幣化的方式，透過限時贖回的方式分享授權收益



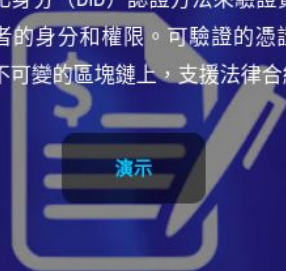
### 合法代幣贖回

代幣化帶來的利潤分享透過合法的贖回程序進行，代幣投資者可以提出一次性或分期贖回；代幣投資者也可以保留所有權而不贖回



### 可驗證的合法憑證

代幣投資者可以根據可驗證憑證上的去中心化身分 (DID) 認證方法來驗證資產所有者的身分和權限。可驗證的憑證儲存在不可變的區塊鏈上，支援法律合約



### 代幣市場

代幣投資者可以在一般以太坊市場上買賣代幣。資產投資者可以在客製化的智慧法律合約上設定不同的出售條款、特許權使用費和時間鎖定，以處理代幣轉售後的權益



## # 研究技術 #

### 芯片層區塊鏈身分

區塊鏈上的資產由公私密鑰對加密。芯片級區塊鏈利用IC芯片儲存私鑰並處理簽名，將區塊鏈安全和資產保護提升到最高水準。

我們的芯片技術為加密錢包提供了不可破解的私鑰管理。

### 多重簽章復原密鑰

加密代幣資產通常使用簡單的單密鑰儲存在加密錢包中，並且僅使用一個助記詞來實現密鑰恢復。

我們的芯片級區塊鏈技術使代幣資產可以由多方用戶和多方簽名管理。此外，如果主密鑰遺失，也可以使用芯片級恢復密鑰。

### 智能法律合約

智能合約一般只能處理一組虛擬的區塊鏈位址碼。芯片級區塊鏈利用真實的IC芯片身份連結真實資產和虛擬事物，由支援法律合約的智慧合約進行資產管理。

我們的智慧法律合約技術使現實生活中的合約能夠在區塊鏈和元宇宙上執行。

### 實體資產代幣化

代幣化不僅限於NFT銷售，現實世界的實體資產投資者可以透過代幣化提前提取投資收益，並與代幣投資者分享任何未來的收益。

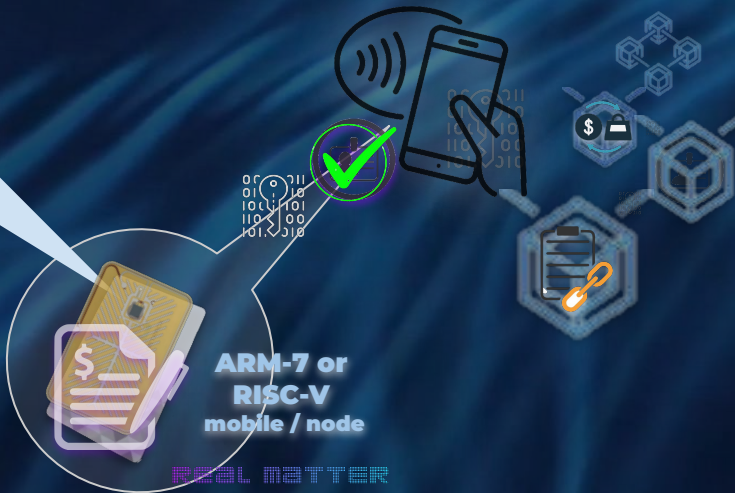
我們的代幣化技術，包括投資者回報計劃，保護實體資產投資者和代幣投資者的利益。

## # 芯片層區塊鏈 # 智能合約芯片



Chip-level Identity for decentralized ID

Wallet App as Gateway executes KYC Identity & AML credentials



Smart Contract-on-chip for verifiable credential

### 芯片層區塊鏈身分

採用 SECORA (Visa PayWave) 晶片來管理私鑰並透過安全 NFC 和有線 I2C 通訊協議處理簽名, 採用可拆卸 SIM 卡的形式

### 芯片上智能合約

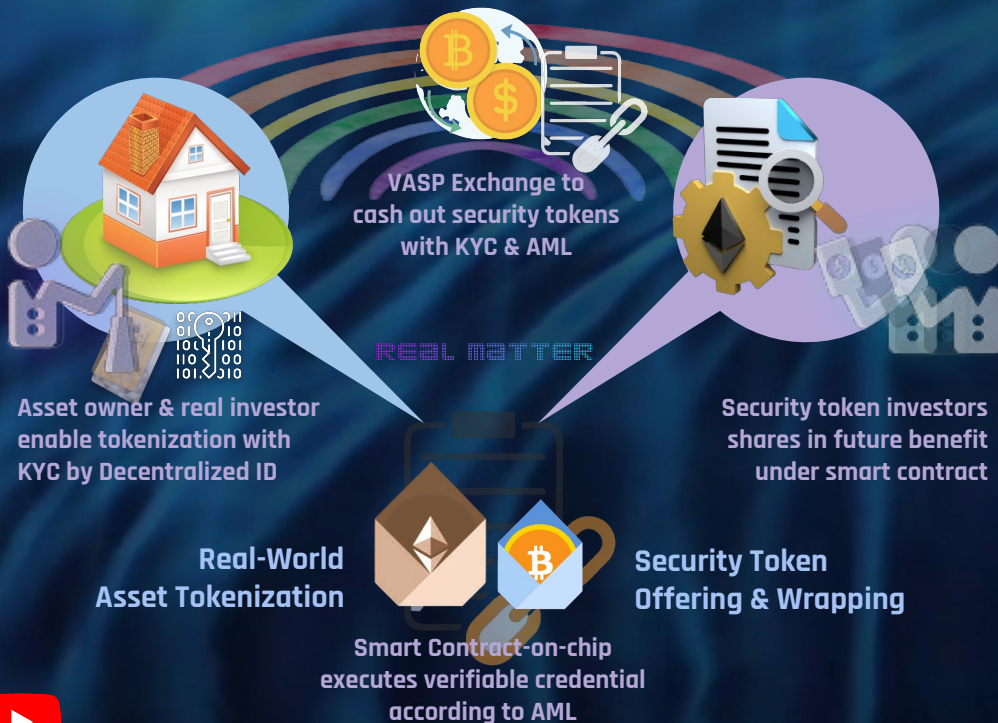
實現了芯片層行動區塊鏈節點, 以微處理器促進節點, 透過智慧合約執行可驗證的憑證



with Art Group Limited



## # 實體資產代幣化 # Web3.0 加密資產



### ECDSA 加密技術

金融監管要求現實世界的資產代幣化在每一步都遵守 KYC 和 AML 合規性, 包括身分認證、所有權憑證以及交易和交換。

芯片層區塊鏈上的 Web3 資產代幣化透過端對端 ECDSA 加密技術以及使用不可破解的芯片身分和芯片憑證來確保安全性



Partner of Artwork Tokenization



# 團隊



吳銘霖

聯合創辦人 | 首席執行官  
MSc BEng MIEEE

資深區塊鏈開發者  
智能合約編碼  
芯片設計師  
美國專利擁有人

科學園公司MIoT前首席技術官  
擁有25年創造芯片、物聯網及區塊鏈的科技成就

[Linkedin me](#)



秦仲宇

聯合創辦人 | 主席  
MSc MRes MBA BSc

資深商業創造者  
新技術總監  
技術系統建築師  
美國專利擁有人

大學講師  
特許工程師  
科技公司Remotec前首席執行官  
擁有30年管理及技術經驗

[Linkedin me](#)



秦若蘭

首席市場官  
MBA BA FMHRM

香港人力資源管理學會  
資深會員  
曾服務於證監會、數碼港及  
公用事業機構  
組織香港業界網絡



何偉業

首席技術官  
MBA MSc BSc

中國半導體工業開創者  
半導體製程技術專家  
與中國半導體工業  
JSMC、FMIC、SiSemi  
長期合作



Paul Cheng 先生

顧問

Vice-chairman and Co-owner at Remotec Technology Ltd,  
Investor in Deltapath and Fufalabs Partner and multiple patent owners.  
30 years in semiconductors, IC Product Marketing.



Emil Chan 教授

顧問

30 Years in Bank IT, FinTech Evangelist and visionary in digital transformation, CBDC, crypto and blockchain advisory.  
Fufalabs Partner



Meikei Jeong 博士

顧問

Chairman - Simbury Ltd.  
Former CTO at ASTRI.  
Over 30 years in Semiconductors and multiple patent owners

# 仲原宇科技有限公司 # REAL MATTER TECHNOLOGY LIMITED #

## 聯絡方法

香港白石角  
香港科學園  
科技大道西 19號  
19W大樓 10樓 1017室

Tel | Whatsapp | Wechat : (852) 5389 7304  
Email : [mn@realmatter.io](mailto:mn@realmatter.io)  
Linkedin : [hk.linkedin.com/in/ngminglam](https://www.linkedin.com/in/ngminglam)  
Web : [www.realmatter.io](http://www.realmatter.io)

我們是無紙化辦公室

